

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局(43) 国際公開日  
2001 年 3 月 1 日 (01.03.2001)

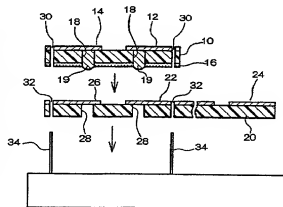
PCT

(10) 国際公開番号  
WO 01/15228 A1

- (51) 国際特許分類: H01L 23/52 (72) 発明者: および  
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 橋元 伸晃  
(HASHIMOTO, Nobuaki) [JP/JP]; 〒392-8502 長野県  
諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会  
社内 Nagano (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP00/05395
- (22) 国際出願日: 2000 年 8 月 11 日 (11.08.2000)
- (25) 国際出願の言語: 日本語 (74) 代理人: 井上 一、外 (INOUE, Hajime et al.); 〒167-  
0051 東京都杉並区荻窪5丁目26番13号 荻窪TMビル2  
階 Tokyo (JP).
- (26) 国際公開の言語: 日本語 (81) 指定国 (国内): CN, JP, KR, US.
- (30) 優先権データ: 特願平11/232565 1999 年 8 月 19 日 (19.08.1999) JP 派付公開書類:  
— 国際調査報告書
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): セイコー  
エプソン株式会社 (SEIKO EPSON CORPORATION)  
[JP/JP]; 〒163-0811 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号  
Tokyo (JP). 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される  
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語  
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: WIRING BOARD, METHOD OF MANUFACTURING WIRING BOARD, ELECTRONIC DEVICE, METHOD OF  
MANUFACTURING ELECTRONIC DEVICE, CIRCUIT BOARD AND ELECTRONIC APPARATUS

(54) 発明の名称: 配線基板及びその製造方法、電子部品及びその製造方法、回路基板並びに電子機器



(57) Abstract: A wiring board comprises a first board (10) having a first wiring pattern (12) and including an area (14) on which an electronic element is mounted, and a second board (20) having a second wiring pattern (22) connected electrically with the first wiring pattern (12). The second board includes an area (26) to which at least part of the first board (10) is attached and an area (24) on which an electronic element is mounted.

(57) 要約:

配線基板は、電子素子の搭載領域 (14) を有して第 1 の配線パターン (12) が形成された第 1 の基板 (10) と、第 1 の基板 (10) の少なくとも一部が貼り付けられている領域 (26) と電子素子の搭載領域 (24) とを有して第 1 の配線パターン (12) と電気的に接続された第 2 の配線パターン (22) が形成された第 2 の基板 (20) と、を含む。